

2026 年 08 月 06 日

证券研究报告·电子行业周报

机构预计手机 SoC 全年销量下滑比例将达到 14%

——中山证券电子行业周报

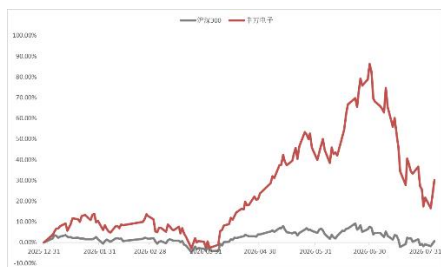
中山证券研究所

分析师：葛淼

登记编号：S0290521120001

邮箱：gemiao@zsq.com

市场走势



投资要点：

●机构预计手机 SoC 全年销量下滑比例将达到 14%。研究机构表示，根据其最新一期《全球智能手机 SoC 出货量初步报告》，全球智能手机 SoC 出货规模在 2026 年上半年出现 15% 的同比衰退。该机构预计全年衰退比例将达到 14%。从供应商角度，联发科与高通这两强的上半年智能手机 SoC 出货量同比降幅均超过 1/4，而其它主要市场参与者——苹果、三星、谷歌、紫光展锐的出货均实现稳健增长。

●机构认为 2027 年下半年 NAND 价格将会松动。TrendForce（集邦）发布预测，认为 DRAM 内存市场在明年维持供给紧张格局，价格走势偏强；而 NAND 闪存供给将在 2027H2 趋向宽松，价格可能面临修正压力。DRAM 和 NAND 走势分化的一大关键点还是两者按容量计的新产能上线进度不同：多数 DRAM 新厂投产放量落于 2027 年下半年，显著的产出贡献则于 2028 年发酵；而 NAND 端则会见到各大厂加速升级至高层数产品与新厂产能逐步释放。

◎回顾本周行情（07 月 31 日-08 月 06 日），本周上证综指上涨 1.94%，沪深 300 指数上涨 2.38%。电子行业表现强于大市。电子(申万)上涨 10.82%，跑赢上证综指 8.88 个百分点，跑赢沪深 300 指数 8.44 个百分点。电子在申万一级行业排名第四。行业估值方面，本周 PE 估值上升至 78.27 倍左右。

◎行业数据：二季度全球手机出货 2.77 亿台，同比增长-6.69%。中国 6 月智能手机出货量 1714 万台，同比增长-16.6%。5 月，全球半导体销售额 1206.1 亿美元，同比增长 104.1%。6 月，日本半导体设备出货量同比增长 26.95%。

◎行业动态：机构预计手机 SoC 全年衰退比例将达到 14%；上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 14.8%；机构预计下半年手机销量依然承压；机构认为 2027 年下半年 NAND 价格将会松动。

◎公司动态：澜起科技：已回购 1.44 亿元公司股票。

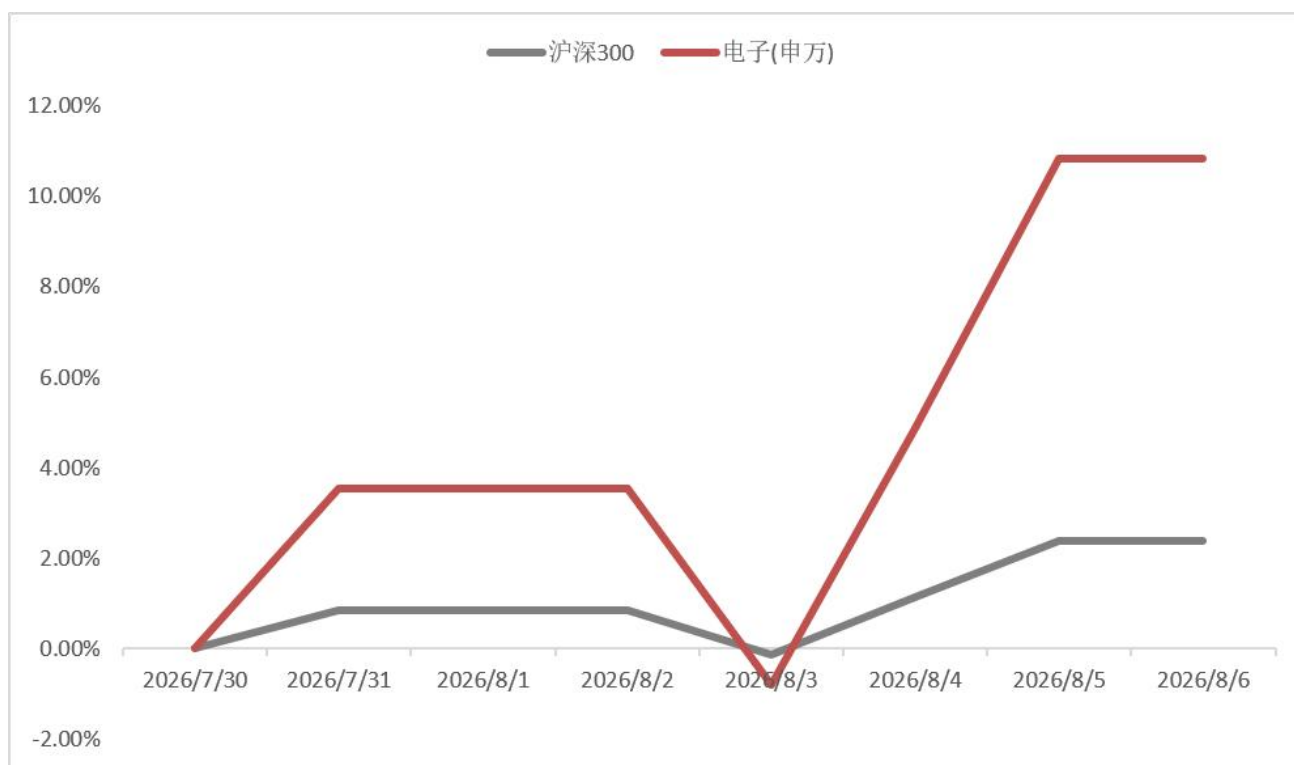
◎投资建议：下游手机销售量增速放缓，未来手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性降低。受 AI 相关需求拉动，存储芯片和生产存储芯片相关的设备和材料需求较好，服务器相关零部件需求较好。

风险提示：宏观需求转弱，上游原材料成本超预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

1. 指数回顾

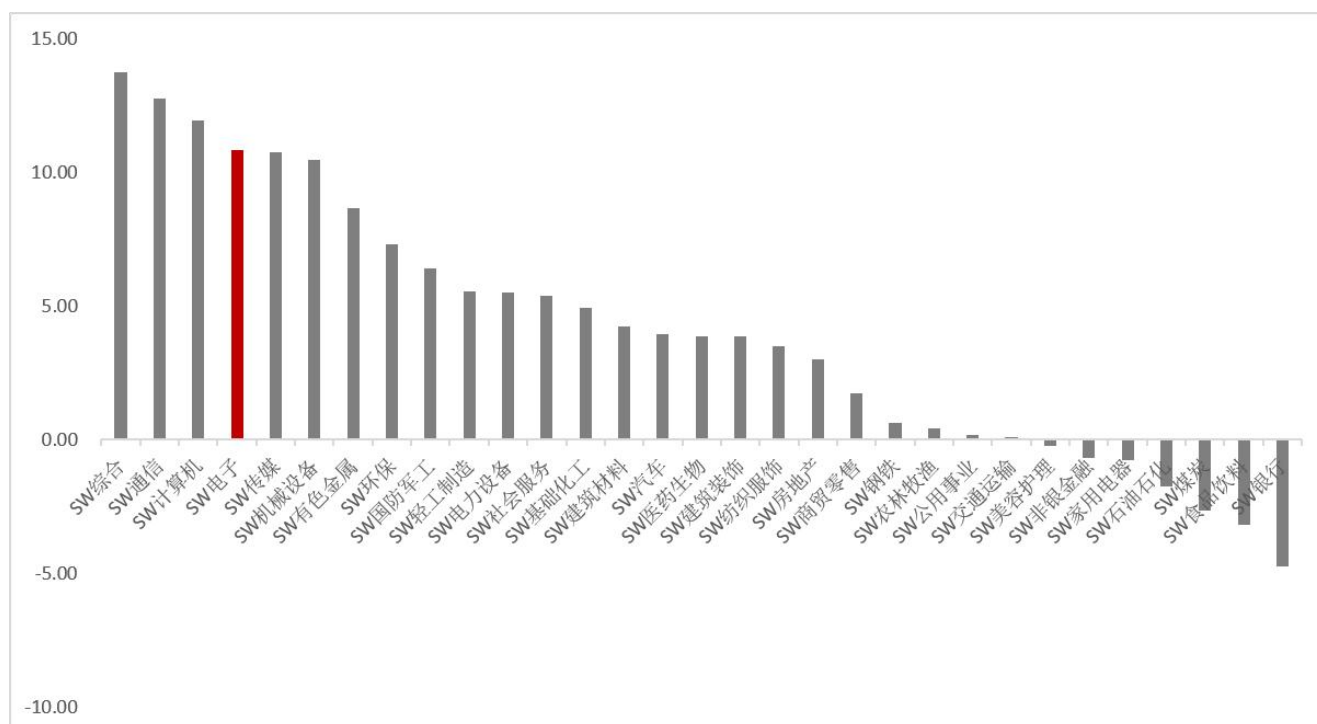
回顾本周行情（07月31日-08月06日），本周上证综指上涨1.94%，沪深300指数上涨2.38%。电子行业表现强于大盘。电子(申万)上涨10.82%，跑赢上证综指8.88个百分点，跑赢沪深300指数8.44个百分点。重点细分行业中，半导体(申万)上涨8.44%，跑赢上证综指6.5个百分点，跑赢沪深300指数6.05个百分点；其他电子II(申万)上涨11.1%，跑赢上证综指9.16个百分点，跑赢沪深300指数8.72个百分点；元件(申万)上涨19.88%，跑赢上证综指17.94个百分点，跑赢沪深300指数17.49个百分点；光学光电子(申万)上涨12.23%，跑赢上证综指10.29个百分点，跑赢沪深300指数9.85个百分点；消费电子(申万)上涨9.31%，跑赢上证综指7.38个百分点，跑赢沪深300指数6.93个百分点。电子在申万一级行业排名第四。行业估值方面，本周PE估值上升至78.27倍左右。

图1. 电子行业本周走势



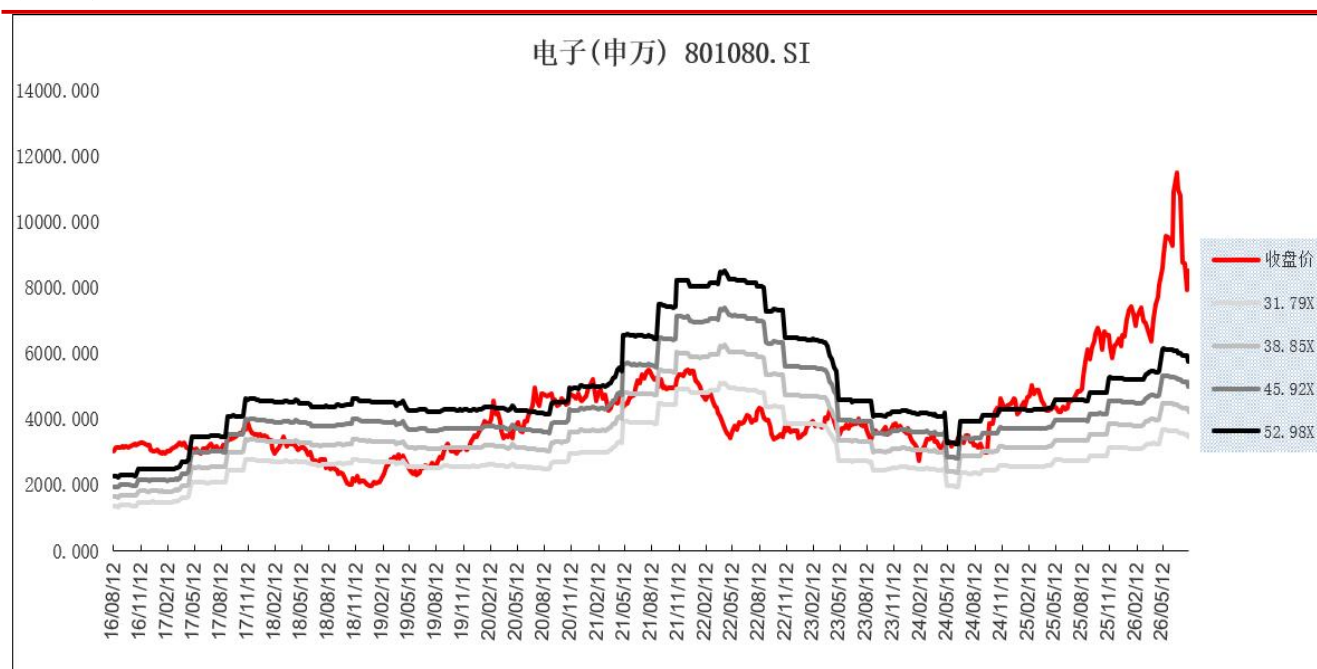
资料来源：Wind，中山证券研究所

图 2. 申万一级行业本周排名



资料来源: Wind, 中山证券研究所

图 3. 电子行业 PE 区间



资料来源: Wind, 中山证券研究所

2.本周观点

全球手机销量同比增速下降。根据 IDC 数据, 2026 年第二季度智能手机出货 2.77 亿台, 同比增长-6.69%, 相比 2026 年一季度的-4.08%小幅下降。

国内手机销量同比增速下降。根据信通院数据,中国 2026 年 6 月智能手机出货量 1714 万台,同比增长-16.6%。增速相比 2026 年 5 月的 19.0%有所下降。

本轮手机销量下滑始于 2024 年四季度,截止 6 月,全球手机销售量数据依然较为平淡,手机产业链公司业绩超预期的可能性较低。

半导体行业景气度上升。2026 年 5 月,全球半导体销售额 1206.1 亿美元,同比增长 104.1%,相比 2026 年 4 月 93.89%的增速有所上升。

半导体设备景气度上升。2026 年 6 月,日本半导体设备出货量同比增长 26.95%,相比 2026 年 5 月增速 17.94%有所上升。

半导体行业景气需求分化,以消费电子为代表的国内半导体需求增速放缓,但与 AI 相关的存储芯片、光芯片相关细分赛道较为景气。能从国内存储厂扩产中获得新订单的半导体设备材料公司有望获得好于行业的表现。

综上所述,下游手机销售量增速放缓,未来手机产业链上的消费电子和半导体器件公司业绩超预期的可能性降低。受 AI 相关需求拉动,存储芯片和生产存储芯片相关的设备和材料需求较好,服务器相关零部件需求较好。

图 4. 全球智能手机出货量 (单位: 百万台)



资料来源: IDC, 中山证券研究所

图 5. 国内智能手机出货量（单位：万台）



资料来源：信通院，中山证券研究所

图 6. 全球半导体销售额（单位：十亿美元）



资料来源：美国半导体产业协会，中山证券研究所

图 7. 日本半导体设备制造商出货量同比



资料来源：wind，中山证券研究所

3.行业动态点评

3.1.机构预计手机 SoC 全年销量下滑比例将达到 14%

CounterpointResearch 表示，根据其最新一期《全球智能手机 SoC 出货量初步报告》，全球智能手机 SoC 出货规模在 2026 年上半年出现 15% 的同比衰退。该机构预计全年衰退比例将达到 14%。

从供应商角度，联发科与高通这两强的上半年智能手机 SoC 出货量同比降幅均超过 1/4，而其它主要市场参与者——苹果、三星、谷歌、紫光展锐的出货均实现稳健增长。

在 iPhone17 系列良好表现的推动下，苹果的 SoC 市场份额已升至 19%，距高通仅剩 3 个百分点；联发科在中低端 5GSoC 领域遭遇冲击；高通则被三星 Exynos2600 抢夺了部分高端市场；紫光展锐则受益于部分入门级机型转向该企业 4G 平台以管控不断膨胀的成本。

（信息来源：IT 之家）

3.2.上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 14.8%

工信部公布 2026 年 1—6 月电子信息制造业运行情况。2026 年上半年，我国电子信息制造业生产继续加快，出口稳定向好，效益保持增势，投资平稳增长，行业整体发展态势良好。

上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 14.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 9.4 个和高 1.5 个百分点。6 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 15.7%。主要产品中集成电路产量 2798 亿块，同比增长 23.1%。

上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 9.41 万亿元，同比增长 18.5%；营业成本 7.98 万亿元，同比增长 15.4%；实现利润总额 5777 亿元，同比增长 96.9%。6 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.89 万亿元，同比增长 24.7%。

（信息来源：IT 之家）

3.3.机构预计下半年手机销量依然承压

Omdia 根据其统计数据表示，全球智能手机市场在 2026 年第 2 季度录得 2.72 亿部的出货量，同比下降 6%。

持续处于高位的内存价格扰乱了供应，增加了零部件成本，迫使智能手机制造商重新思考整体策略。行业的重点正从最大化出货量转向保护利润率和平均销售价格(ASP)，推动市场向高端化转型。

机构认为高昂的零部件成本预计将在今年后半段持续对智能手机市场施加压力。虽然出货量下降的速度在第二季度大幅调整后应会有所缓和，但整体销量不太可能在零部件成本开始缓解之前恢复。

而从制造商的层面来看，三星继续位居全球第一大智能手机企业，也是前五中唯一一家出货增长的 Android 智能手机制造商；苹果逆势实现 23% 出货提升，20% 的市场占有也创下同期新高；小米、OPPO、vivo 则都出现较为严重的衰退。

（信息来源：IT 之家）

3.4.机构认为 2027 年下半年 NAND 价格将会松动

TrendForce（集邦）发布预测，认为 DRAM 内存市场在明年维持供给紧张格局，价格走势偏强；而 NAND 闪存供给将在 2027H2 趋向宽松，价格可能面临修正压力。

DRAM 和 NAND 走势分化的一大关键点还是两者按容量计的新产能上线进度不同：多数 DRAM 新厂投产放量落于 2027 年下半年，显著的产出贡献则于 2028 年发酵；而 NAND 端则会见到各大厂加速升级至高层数产品与新厂产能逐步释放。

此外，由于 HBM 制造流程所需的晶圆投入远高于一般 DRAM，导致新增内存投产量无法按比例转换为有效容量产出，DRAM 领域的容量缺口将从今年的 1~2% 进一步扩大。

当然，内存成本过高反作用于云服务供应商资本支出规划、代理式 AI 普及取得突破式进展而再度拉动高速固态硬盘的需求等都是可能出现的情况。

（信息来源：IT 之家）

4. 公司动态

4.1. 澜起科技：已回购 1.44 亿元公司股票

澜起科技 8 月 3 日晚间发布公告称，截至 2026 年 7 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 70.5 万股，占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 210 元/股，最低价为 192.18 元/股，支付的金额总额约为人民币约 1.44 亿元。

（信息来源：每日经济新闻）

风险提示：宏观需求转弱，上游原材料成本超预期，行业竞争格局恶化，贸易冲突影响。

分析师介绍：

葛森：中山证券研究所行业组 TMT 行业分析师。

投资评级的说明**一行业评级标准**

报告列明的日期后3个月内，以行业股票指数相对同期市场基准指数（中证800指数）收益率的预期表现为标准，区分为以下四级：

强于大市：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在5%以上；

同步大市：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%~5%之间波动；

弱于大市：行业指数收益率相对市场基准指数收益率在-5%以下；

未评级：不作为行业报告评级单独使用，但在公司评级报告中，作为随附行业评级的选择项之一。

一公司评级标准

报告列明的发布日期后3个月内，以股票相对同期行业指数收益率为基准，区分为以下五级：

买入：强于行业指数15%以上；

持有：强于行业指数5%~15%；

中性：相对于行业指数表现在-5%~5%之间；

卖出：弱于行业指数5%以上；

未评级：研究员基于覆盖或公司停牌等其他原因不能对该公司做出股票评级的情况。

要求披露

本报告由中山证券有限责任公司（简称“中山证券”或者“本公司”）研究所编制。中山证券有限责任公司是经监管部门批准具有证券投资咨询业务资格的机构。

风险提示及免责声明：

★市场有风险，投资须谨慎。本报告提及的证券、金融工具的价格、价值及收入均有可能下跌，以往的表现不应作为日后表现的暗示或担保。您有可能无法全额取回已投资的金额。

★本报告无意针对或者打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。

★本报告是机密的，仅供本公司的个人或者机构客户（简称客户）参考使用，不是或者不应当视为出售、购买或者认购证券或其他金融工具的要约或者要约邀请。本公司不因收件人收到本报告而视其为本公司的客户，如收件人并非本公司客户，请及时退回并删除。若本公司之外的机构发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，本公司及本公司雇员不为前述机构之客户因使用本报告或者报告载明的内容引起的直接或间接损失承担任何责任。

★任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等都只是研究观点的简要沟通，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

★ 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但是本公司不保证该资料及信息的准确性、完整性，我公司将随时补充、更新和修订有关资料和信息，但是不保证及时公开发布。本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告列明的发布日期当日的判断，本公司可以在不发出通知的情况下做出更改。本报告所包含的分析基于各种假设和标准，不同的假设和标准、采用不同的观点或分析方法可能导致分析结果出现重大的不同。本公司的销售人员、交易人员或者其他专业人员、其他业务部门也可能给出不同或者相反的意见。

★ 本报告可能附带其他网站的地址或者超级链接，对于可能涉及的地址或超级链接，除本公司官方网站外，本公司不对其内容负责，客户需自行承担浏览这些网站的费用及风险。

★ 本公司或关联机构可能会持有本报告所提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能已经、正在或者争取向这些公司提供投资银行业务等各类服务。在法律许可的情况下，本公司的董事或者雇员可能担任本报告所提及公司的董事。撰写本报告的分析师的薪酬不是基于本公司个别投行收入而定，但是分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投行、销售与交易业务。因此，客户应当充分注意，本公司可能存在对报告客观性产生影响的利益冲突。

★ 在任何情况下，本报告中的信息或者所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，任何人不应将本报告作为做出投资决策的惟一因素。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不就本报告的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。除法律强制性规定必须承担的责任外，本公司及雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

★ 本报告版权归本公司所有，保留一切权利。除非另有规定外，本报告的所有材料的版权均属本公司所有。未经本公司事前书面授权，任何组织或个人不得以任何方式发送、转载、复制、修改本报告及其所包含的材料、内容。所有于本报告中使用的商标、服务标识及标识均为本公司所有。